

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年5月19日 (19.05.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2005/045925 A1

(51)国際特許分類:

H01L 23/12

CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3812287 長野県長野市小島田町 80 番地 Nagano (JP).

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/016244

(72)発明者; および

(22)国際出願日:

2004年11月1日 (01.11.2004)

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 高池 英次 (TAKAIKE, Eiji) [JP/JP]; 〒3812287 長野県長野市小島田町 80 番地 新光電気工業株式会社内 Nagano (JP).

(25)国際出願の言語:

日本語

(74)代理人: 伊東 忠彦 (ITOH, Tadahiko); 〒1506032 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー32階 Tokyo (JP).

(26)国際公開の言語:

日本語

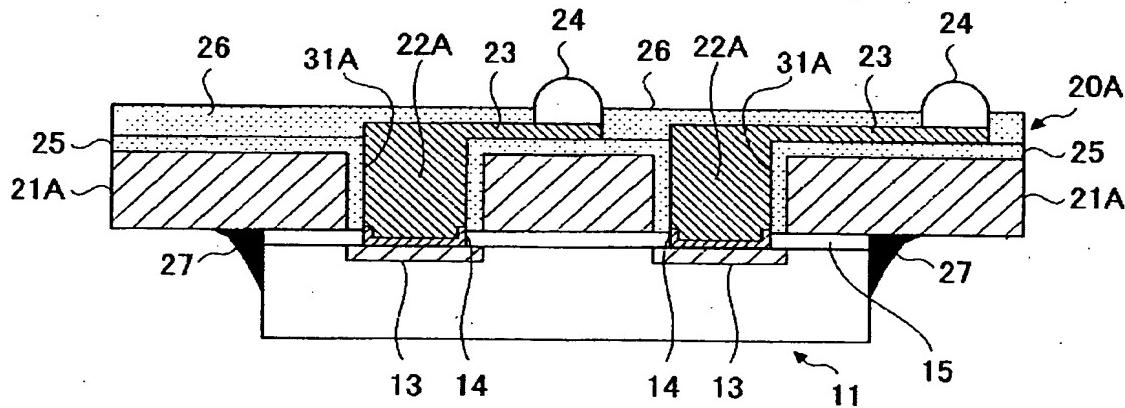
(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE AND PROCESS FOR MANUFACTURING SAME

(54)発明の名称: 電子装置及びその製造方法

10A



WO 2005/045925 A1

(57) Abstract: A semiconductor device wherein a semiconductor chip is electrically connected with a packaging substrate through an interposer and a process for manufacturing the same. An electronic device comprises an electronic element, an interposer base to which the electronic element is bonded, and an interposer having a plurality of post electrodes to be connected with the electrodes of the electronic element. In this electronic device, the electronic element and the interposer base are integrated by being brought into direct contact with each other, and the post electrodes are formed directly on the electrodes of the electronic element.

(57) 要約: 本発明はインターポーザを介して半導体チップを実装基板に電気的に接続する構成とされた半導体装置及びその製造方法に関し、電子素子と、前記電子素子が接合されるインターポーザ基材と、前記電子素子の電極と接続される複数のポスト電極とを有するインターポーザとを具備する電子装置において、前記電子素子と前記インターポーザ基材とを直接接触させることにより一体化すると共に、前記ポスト電極を前記電子素子の電極上に直接形成した構成とする。



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。